



美格智能 SRM813Q模组

5G RedCap轻量化LGA封装
小尺寸全功能模组

美格智能 SRM813Q 系列模组是一款专为IoT/eMBB应用而设计的5G RedCap 轻量化模组,基于高通技术公司的骁龙®X35 5G调制解调器及射频系统设计,符合最新的3GPP Release 17标准及特性,支持5G独立组网(SA)方式并向下兼容4G网络,可覆盖全球主流运营商网络。可支持64QAM/256QAM(可选)调制方式,理论下行峰值速率可达220Mbps,理论最大上行速率可达120Mbps,相比4G Cat.4产品可获得更高的上下行速率。

该模组采用LGA封装,尺寸为:29x32x2.4mm,可提供丰富的功能接口方便用户进行外设扩展,支持USB2.0、PCIe2.0、SGMII、SDIO、SPI、多路UART、ADC、GPIO等接口,4G/5G采用2天线设计,内部预留eSIM支持;可适配多种类型操作系统(Android、Linux、Windows等),同时内置了丰富的网络协议。

SRM813Q系列模组通过精简系统架构,可实现更低的成本、更少的天线数量、更小的尺寸及更低的功耗,将强有力赋能移动宽带、工业互联网、智慧能源、视频监控、笔电、车联网、智能穿戴等垂直行业,加速5G规模化商用。

主要优势:

- ▣ 5G RedCap轻量化模组,更高性价比
- ▣ 小尺寸LGA封装,与4G Cat.4产品Pin to Pin设计
- ▣ 两天线全频段设计,降低5G终端设计复杂度
- ▣ 支持网络切片、5G LAN和高精度授时等特性



5G NR



SA & LTE



LGA封装



USB2.0 Port



PCIe 2.0



-40°C-85°C



VoNR/VoLTE*

MeiG Smart SRM813Q模组

5G RedCap轻量化LGA封装小尺寸全功能模组

MEIG 美格

股票代码:002881

基本属性:

- 封装: LGA 封装
- 尺寸: 29.0×32.0×2.4mm
- 重量: <8g

模组速率:

- 5G NR SA:
 - Downlink up to 220Mbps
 - Uplink up to 120Mbps
- LTE:
 - Downlink up to 200Mbps
 - Uplink up to 75Mbps

驱动&工具:

- 驱动: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Android
- 工具: 图形化升级工具, 多系统下日志工具
- USB升级, FOTA升级

网络协议:

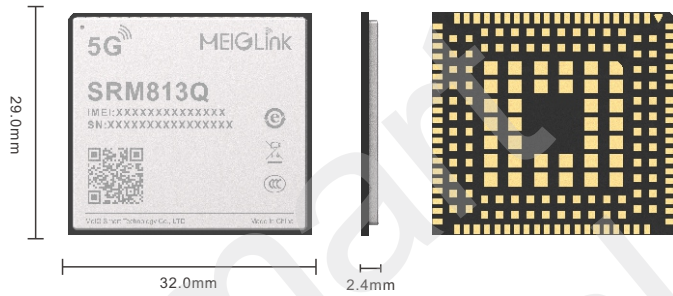
- RNDIS/NDIS/IPv4/IPv6/TCP/UDP

模组接口:

- USB2.0 × 1
- PCIe Gen2.0 × 1
- SDIO3.0 x1
- SGMII x1
- USIM × 2 1.8V/3V
- 3个天线接口:
 - 4G/5G x2
 - GNSS x1

认证信息:

- CCC*/SRRC*/CTA*/CE*/FCC*



发射功率:

- Class 3 (23dBm±1.5dB) for 5G & LTE

环境温度湿度特性:

- 正常工作温度: -30°C to +75°C
- 扩展工作温度: -40°C to +85°C
- 存储温度: -40°C to +90°C
- 湿度: 5%~95%

SRM813Q系列频段信息:

-CN:Region: China

5G NR:

FDD:N1/N5/N8/N28

TDD:N41/78

LTE:

FDD:B1/B3/B5/B8

TDD:B34/B38/B39/B40/B41

-NA:Region:North America

5G NR:

FDD:N2/N5/N7/N12/N13/N25/N66/N71

TDD:N38/N41/N48/N77/N78

LTE:

FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71

TDD:B38/B41/B42/B43/B48

-EA:Region:Europe, Australia, Japan, Korea, Southeast Asia

5G NR:

FDD:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28

TDD:N38/N40/N41/N77/N78

LTE:

FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

TDD:B38/B40/B41/B42/B43

备注: * 研发中

